

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月13日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于预计公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司2025年为合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币224,800万元，担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过78,000万元，为资产负债率70%以上（含）的子公司提供担保的额度不超过146,800万元。

二、本次担保情况

根据业务发展需要，博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”）向合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行（以下简称“科农行”）申请签署授信合同，具体金额以实际签署的授信合同（以下简称“主合同”）为准。公司与科农行于近日签署《最高额保证合同》，同意为主合同项下债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币陆仟万元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，具体起算日以合同条款为准。

截至本公告披露日，公司实际为博讯光电提供担保额度总额共计人民币 10.38 亿元（实际使用额度 7.3225 亿元），担保额度在已审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称：博讯光电科技（合肥）有限公司

成立日期：2014 年 3 月 10 日

注册地址：合肥市新站区大禹路 699 号

法定代表人：肖志光

注册资本：53,192.40 万元人民币

经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑材料销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；石油制品制造（不含危险化学品）；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其 100%股权。

主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
资产总额	2,278,114,311.82	2,478,161,577.17
负债总额	1,726,110,683.98	1,936,037,570.39
净资产	552,003,627.84	542,124,006.78
资产负债率	76%	78%
营业收入	764,202,642.79	1,232,937,480.07

主要财务指标	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月(未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度(经审计)
净利润	8,971,386.68	-47,041,551.21

注：上述数据为单体报表数据

信用情况：博讯光电不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

被担保方：博讯光电科技（合肥）有限公司；

债权人：合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行；

保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司；

担保金额：担保的最高债权额为人民币陆仟万元整及主债权所产生的利息及其他应付款项之和；

保证方式：连带责任保证；

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年。具体起算日以合同条款为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保情况如下：

被担保方	担保额度 (万元)	实际担保余额 (万元)	公告披露日期	是否资产负债率超过70%
重庆博硕光电有限公司	19,000	8,705	2024/11/20	否
	12,000	5,998	2022/11/21	
	5,000	1,290	2023/11/7	
	6,000	3,284	2023/5/22	
	15,000	2,408	2023/12/19	
小计	57,000	21,685	-	
博讯光电科技（合肥）有限公司	13,000	9,987	2024/4/18	是
	10,000	9,000	2022/1/27	

被担保方	担保额度 (万元)	实际担保余额 (万元)	公告披露日期	是否资 产负 债 率 超 过 70%
	10,000	9,183	2024/2/23	
	7,000	4,734	2025/4/11	
	10,000	5,700	2025/5/28	
	10,000	9,263	2025/10/28	
	7,800	6,061	2024/4/9	
	10,000	9,817	2024/12/12	
	20,000	9,480	2025/9/10	
	6,000	0	本次新增	
小计	103,800	73,225	-	
合肥星宸新材料有限公司	2,000	1,470	2024/3/19	否
	500	500	2025/6/23	
小计	2,500	1,970	-	
重庆汇翔达电子有限公司	500	500	2024/6/24	否
小计	500	500	-	
博晶科技（滁州）有限公司	150,000	93,529	2022/4/29	是
	5,000	4,918	2025/3/20	
	5,000	3,583	2025/6/23	
	2,000	1,781	2025/8/13	
	3,000	2,998	2025/8/13	
小计	165,000	106,809	-	
博昇科技(滁州)有限公司	5,000	4,394	2025/6/23	是
小计	5,000	4,394	-	
青岛欧迅光电有限公司	1,000	1,000	2025/3/20	否
小计	1,000	1,000	-	
重庆翰博显示科技有限公司、重庆翰博显示科技研发中心有限公司（注1）	27,500	27,500	2020/10/13	是
小计	27,500	27,500	-	
合计	362,300	237,083	-	-

注1：重庆翰博显示科技有限公司与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（简称“两江投资公司”）于2020年10月22日签署《翰博高新背光模组和研发中心项目代建协议》，重庆翰博显示

科技有限公司委托两江投资公司建设翰博高新背光模组和研发中心项目，公司提供保证，保证期间到代建合同债务结束。

注 2:若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,系由四舍五入导致。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司已审议通过的累计可对外担保总额为 40.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 386.03%。本次提供担保后，公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额为 36.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 347.65%，实际担保余额为 23.71 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 227.49%。担保均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保，不存在其他对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日